

正本

經濟部智慧財產局專利核駁審定書

受文者：松下電器產業股份有限公司（代理人：

林鎰珠 先生）

地址：台北市長安東路二段一一二號九樓

法定

發文日期：中華民國九十一年十一月一日

發文字號：（九一）智專二（三）05022字

第〇九一八三〇一九二二號



專利分類IPC(7)：... H05K 1/02, 3/00

- 一、申請案號數：〇九〇一〇二八六五
- 二、發明名稱：轉寫材及其製造方法及使用該轉寫材製造出之配線基板
- 三、申請人：

名稱：松下電器產業股份有限公司

地址：日本

四、專利代理人：

姓名：林鎰珠 先生

地址：台北市長安東路二段一一二號九樓

五、申請日期：九十年二月九日

六、優先權項目：

1 2000/02/09 日本2000-031422

2 2000/04/12 日本2000-110307

3 2000/10/24 日本2000-324524

七、審查人員姓名：潘昭彥 委員

八、審定內容：

主文：本案應不予專利。

依據：專利法第十九條、第二十條第二項。

理由：

- (一) 本案轉寫材及其製造方法及使用該轉寫材製造出之配線基板，其特徵在於具備：第一金屬係作為轉寫件，第二金屬層係作為配線圖案，剝離層係在於第一金屬層與第二金屬層之間，以能自第一金屬層和第二金屬層剝離的方式來貼合之至少三層，在第一金屬層的表層部，形成與配線圖案相對應之形狀凸部，在凸部區域上形成剝離層及第二金屬層。
- (二) 按本案運用鍍鎳金屬存在於以銅、銀材質之第一、二金屬層間作剝離層之技術，已普遍使用在基材及免錫球陣式積體電路上，乃業者慣用之既有技術，如附件八十三年二月一日公告第二二〇〇二七號、八十七年九月十一日公告第三四〇二九七號專利案所示，本案雖然在第一、二金屬層凸部配線圖案及第三、四金屬層轉寫空間配置上有所變化，惟僅係既有裝置之改變，其所運用之技術原理乃屬習知，為熟習該項技術者所能輕易完成者。

(三) 綜上所述，本案僅係既有裝置之改變，乃運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，顯非技術思想之高度創作，難符發明專利要件。

據上論結，本案不符法定專利要件，爰依專利法第十九條、第二十條第二項，審定如主文。

局長
蔡練生

依照分層負責規定授權單位主管決行

如不服本審定，得於文到之次日起三十日內，備具再審查理由書一式二份及規費新台幣陸仟元整（專利說明書及圖式合計在五十頁以上者，每五十頁加收新台幣五百元，其不足五十頁者以五十頁計），向本局申請再審查。